

## 硅片晶圆超声波清洗机



### 简介

硅片晶圆生产清洗工艺中，使用超声波清洗机有效去除硅片晶圆表面的有机物、颗粒、金属杂质、自然氧化层及石英、塑料等附件器皿的污染物，且不破坏晶片表面特性。根据不同清洗工艺配置相应的清洗单元，各部分有独立控制，随意组合。

### 结构

- 1、采用三套独立的电脑控制机械臂自动化作业
- 2、采用第三代最新技术，全面完善的防酸防腐措施，保护到机器每一个角落
- 3、最新全自动补液技术
- 4、独特的硅片干燥前处理技术，保证硅片干燥不留任何水痕
- 5、成熟的硅片干燥工艺，多种先进技术集于一身
- 6、彩色大屏幕人机界面操作，方便参数设置多工艺方式转换

### 特点

- 1、械手或多机械手组合，实现工位工艺要求。
- 2、PLC全程序控制与触摸屏操作界面，操作便利。
- 3、自动上下料台，准确上卸工件。
- 4、净化烘干槽，独特的烘干前处理技术，工作干燥无水渍。
- 5、全封闭外壳与抽风系统，确保良好工作环境。
- 6、具备抛动清洗功能，保证清洗均匀。

7、全封闭清洗均匀。

8、全封闭外壳与抽风系统，确保良好工作环境。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4435.html>